

上海建桥学院教学进度安排表

2012 ~ 2013 学年度第 一 学期

课程名称：集成电路封装技术

班级：微电子 B10-1

总学时：48

日期	周次 星期	课 程 内 容			授课 方式	上课地点	作业 布置
		章	节	内 容			
9/3	1/一	1		概述 1	讲课		有
9/10	2/一	1-2		概述 2 微电子器件和组装材料	讲课		有
9/17	3/一	3		* 技术基础——电磁兼容性 1	讲课		有
9/24	4/一	3		*技术基础——电磁兼容性 2 * 技术基础——电磁兼容性 3	讲课		有
10/1	5/一			国庆节放假			
10/8	6/一	4		*技术基础——热控制 1 *技术基础——热控制 2	讲课		有
10/15	7/一	4		*技术基础——热控制 3	讲课		有
10/22	8/一	5		*技术基础——防潮与防腐蚀 1 *技术基础——防潮与防腐蚀 2	讲课		有
10/29	9/一			期中复习	复习		复习
11/5	10/一	5-6		*技术基础——防潮与防腐蚀 3 *技术基础——防振与防冲击	讲课		有
11/12	11/一	7		*技术基础——互连与连接	讲课		有
11/19	12/一	8		传统塑料封装工艺技术 1 传统塑料封装工艺技术 2	讲课		有
11/26	13/一	9		陶瓷封装工艺技术	讲课		有
12/3	14/一	10-11		厚薄膜混合工艺技术 先进封装体及其工艺技术 1	讲课		有
12/10	15/一	11		先进封装体及其工艺技术 2	讲课		有
12/17	16/一	11-12		先进封装体及其工艺技术 3 封装可靠性和缺陷分析	讲课		有
12/24	17/一			期末复习	复习		

注：授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核，不够写可续页。

任课教师：贺德洪

系主任审核：

教学院长审核：

日期：2012. 9. 1

日期：

日期：